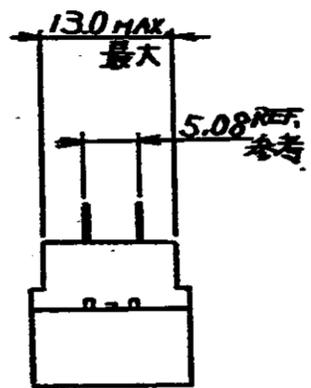


推奨基板寸法
RECOMMENDED
P.C. BOARD DIMENSION.



注記

△ ヲキ仕様 : コンタクト接触部 : 1.3μMIN. のニッケル下地 ヲキの上ヒ 0.76μMIN. の金 ヲキ
アクション部 : 1.3μMIN. のニッケル下地 ヲキの上ヒ 2.5μ MAX の 羊田 ヲキ

NOTE

△ FINISH CONTACT AREA: 1.3μMIN. NICKEL UNDER PL. 0.76μMIN. GOLD PL.
ACTION AREA: 1.3μMIN. NICKEL UNDER PL. 2.5μ MAX. TIN-LEAD PL.

単位: MM DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT Proj. No. 65F-017

2.65	↑	-2	ベース ハウジング	BASE HOUSING	3
3.2	↑	174158 -1	熱可塑性樹脂 ハウジング	THERMOPLASTIC COVER HOUSING	2
"A" DIA	↑	型番 PIN	銅合金	COPPER ALLOY CONTACT	1
			材料 MATERIAL	名称 NAME	ITEM No.

AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP
TOKYO, JAPAN

WIRE RANGE	INSULATION DIA	SERIAL NO	
SEE TABLE	SEE NOTE	SIZE	LOC
DR. 7/20/90	DE. 7/20/90	B	J
CHK. Sasaki	APR. 7/20/90	REV. 0	SHEET 1 OF 1